



ORION RS610-G3

Dual socket rackmount server

技術仕様



フォームファクター	1Uラックマウントサーバ
チップセット	インテル® C612チップセット
プロセッサ	2個のインテル® XEON® プロセッサ E5-2600 v3/v4製品ファミリー搭載、TDP (熱設計電力) 最大145W
QPI	最大9.6 GT/s
メモリ容量	最大1536GB (LRDIMM)
メモリサイズとタイプ	RDIMM: ECC DDR4 2400/2133/1866/1600/1333 MHz (4GB/8GB/16GB/32GB) LRDIMM: ECC DDR4 2400/2133/1866/1600/1333 MHz (32GB/64GB)
ネットワーク	インテル® i350-AM2、2 x GbEポート + 1 x 管理用GbEポート 2 x 10GbE SFP+ポート (OCPメザニンカード経由、オプション)
ビデオ	Aspeed® AST2400 (32MB VRAM)
ストレージコントローラ	オンボード インテル® C612チップセット - 2 x MiniSASポート + 2 x SATA3 6Gbpsポートまたは2 x MiniSASポート + 1 x SATA3 6Gbpsポート + 1 x M.2 コネクタ - RAID 0, 1, 5, 10をサポート ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード (オプション)
ドライブベイ	最大4台 (3.5") または8台 (2.5") のホットスワップ対応SATA/SASドライブ
最大内部ストレージ容量	最大24TB (3.5" HDDの場合) または16TB (2.5" HDDの場合)
光学ドライブ	1 x スリム型DVD-RWドライブ (オプション)
拡張スロット	1 x PCIe 3.0 x16 (フルハイト、ハーフレングス) + 1 x PCIe 3.0 x8 (ロープロファイル、ハーフレングス) + 1 x PIKEスロット + OCPスロット
I/Oポート	3 x RJ45、2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x VGA、1 x PS2
電源装置	800W冗長電源装置 (1+1) 80 Plus® プラチナ認定
環境条件	動作時温度: 10°C~35°C (50°F~95°F) 非動作時温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F) 非動作時相対湿度: 20%~90% (結露しないこと)
寸法	686 mm (奥行) x 444 mm (幅) x 44 mm (高さ)
重量	18kg
保証	3年保証: 交換パーツ3年間無償保証



Speed | Performance | Passion for Innovation



Technology
Provider
Platinum 2016



Scalable Systems Co., Ltd.

スケーラブルシステムズ株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2 BUREX 麹町 11階
電話: 03-5875-4718 FAX: 03-3237-7612 www.sstc.co.jp

©2016 Scalable Systems Co., Ltd. All rights reserved. 仕様は予告なく変更されることがあります。CIARAロゴ、ORIONおよびORIONロゴは、Ciara Technologiesの商標です。
本書に記載されているその他の商標は、それぞれの所有者に所有権が帰属します。

06/2016